



(地独) 大阪産業技術研究所 和泉センター

技術講習会

高速シリコンディープエッチング装置

当研究所では、公益財団法人 JKA の平成 27 年度公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業により「高速シリコンディープエッチング装置」を導入しました。この装置は、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)デバイスの作製に良く使われます。この度、高速シリコンディープエッチング装置を用いた MEMS 加工を広く普及することを目的として、本装置の技術講習会を下記の要領で開催いたしますので、ご案内申し上げます。

◆日 時： 令和元年 9 月 27 日 (金) ① 9:45~11:45 ② 13:15~15:15

①, ②とも同じ内容の講習を行います。ご希望の時間帯をお選び下さい。

(バスでお越しの場合、①9:27 ②12:54 に和泉中央駅を出発するバスで間に合います。)

○当研究所内に食堂がございます。一般の方もご利用になれます。(営業時間：11:45~13:15)

◆場 所：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター (和泉市あゆみ野2-7-1)

当日は、講習開始時刻までに当研究所の玄関ホール 講習会受付にて、受付をお済ませください。担当者が講習会場にご案内します。(受付は講習会開始時間の 10 分前より始めます。)

◆定 員： 3 名

※ 受講票は発行いたしません。返信で受付をお知らせします。

◆費 用： 無料

◆申込み先：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター 顧客サービス部

※ お申込みは、メール (fukyu@tri-osaka.jp) または FAX (0725-51-2520) でお願います。

◆対象機器：高速シリコンディープエッチング装置

高速シリコンディープエッチング(DRIE)装置MUC-21ASE-SRE (SPPテクノロジーズ株式会社)を用いた初心者向けの講習を開催します。本講習では、機器の概要説明を行った後、装置の操作方法を説明しながら、実習用のサンプルを実際に加工いたします。その後、走査電子顕微鏡により形状観察した結果を紹介します。



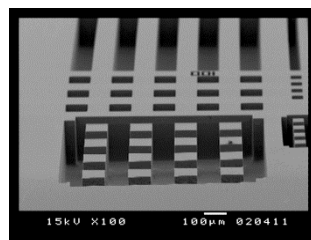
機器型番：MUC-21 ASE-SRE
(SPP テクノロジーズ株式会社)

◆持ち込み試料について：本講習会では、受講者による持ち込み試料の対応はいたしません。

◆講習担当：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター

電子・機械システム研究部

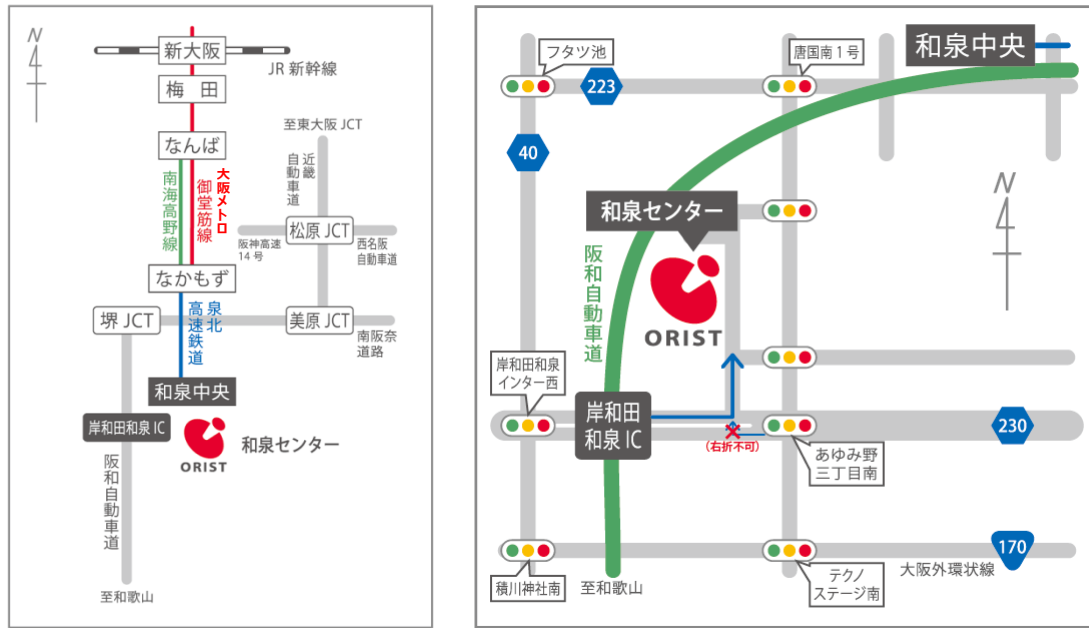
田中恒久, 村上修一



シリコン基板の加工例

・お問い合わせ先：顧客サービス部 TEL：0725-51-2518

大阪産業技術研究所 和泉センター 交通案内図（略図）



和泉中央駅バス乗り場5番から
研究所方面へのバスが出ております
和泉中央駅発バス時刻
9時：7, 27分
10時：3, 34, 57分
11時：21, 54分
12時～15時：毎 24, 54分

駐車場は、入口から入って左手に
あります。ご利用下さい。

「大阪技術研前」で下車して下さい

FAX 0725-51-2520

技術講習会 申込書 テーマ「高速シリコンディープエッチング装置」 開催日：令和元年9月27日（金）

会社名			
所在地	(〒 -)		
参加者	所属：	役職：	氏名： (K)
	所属：	役職：	氏名： (K)
利用者カードをお持ちの方は、「K番号」のご記入もお願いします。			
連絡先	TEL：	FAX：	
希望コース (第1希望～第2希望までのコース番号をご記入ください)	第1希望：	第2希望：	
	① 令和元年9月27日（金） 9：45～11：45		
② 令和元年9月27日（金） 13：15～15：15			
講習会の情報源	①Web ページ ②メール配信 ③チラシ ④他機関の情報 ⑤その他 ()		

※上記参加申込書に記載された内容につきましては、本講習会の参加者の集計及び下記の目的に使用させていただきます。

- ①お客様からの問い合わせへの対応、当研究所利用に関する手続きの案内など、お客様サポート。
- ②当研究所および関連団体の催事情報提供などの案内。

※ 講習会の申込状況の確認はこちら →<http://orist.jp/izumi/events/seminar/>

※ 講習会の案内など、当研究所の関連情報をお知らせする「ORIST EXPRESS 和泉センター版」の配信を新規にご希望の方はこちら →http://orist.jp/mail_magazine/magazine_izumi.html